

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 二〇二二年度董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）2022 年度公司经营情况

##### 1、整体情况概述

2022 年政府工作报告提出：着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。继续做好‘六稳’‘六保’工作。宏观政策有空间有手段，要强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑、保持宏观政策连续性，增强有效性。政策发力适当靠前，及时动用储备政策工具，确保经济平稳运行。继 2014 年提出“新 5%比旧 8%好”，2015 年提出“经济 L 型”，2017 年提出“新周期”，2018 年提出“金融周期顶部”，2019 年年初预测“否极泰来”，2020 年初倡导“新基建”，2021 年初预测“通胀预期和流动性拐点”，2022 年初提出五大关键词“双周期、稳增长、宽货币、新基建、软着陆”。

“十四五”规划提出：系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。新基建短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于培育新经济、新技术、新产业，打造中国经济新引擎，是兼顾短期扩大有效需求和长期扩大有效供给的重要抓手，是应对疫情、经济下行和高质量发展的有效办法，具有稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生的综合性意义。《报告》提出加强数字中国建设整体布局，包括 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、以及产业数字化等。

海关总署公布的 2022 年进出口主要商品数据，我国货物贸易进口总值达 2.72 万亿美元。其中，集成电路进口总金额为 4155.79 亿美元，占比达 15.30%。虽然

集成电路进口额同比下降 3.9%，但仍然超过同期原油进口金额 3655.12 亿美元，持续是我国第一大进口商品。集成电路产品仍是国家亟待改善的“薄弱环节”，近年来国家对集成电路的重视程度史无前例，政策持续加码，在“十四五”规划中，集成电路成为强化国家战略科技力量的重点领域，支持战略性前瞻性技术发展。此外，5G、人工智能、物联网、新能源汽车等新兴技术推动下，各行业对于芯片产品的需求持续增加，这也是 2022 年芯片市场保持活力的主要原因之一。

集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片和模拟芯片四种类型，从产品组成结构来看，微控制芯片的占比逐渐降低，逻辑芯片的占比相对稳定，而存储芯片和模拟芯片的占比提升明显。并且随着存储芯片的大幅涨价，成为增长最快的集成电路产品。并且受益于下游智能手机、AI、数据中心、汽车、物联网等多领域应用持续放大，DRAM 和 NAND 为主导的存储芯片仍将保持高速增长。模拟芯片最主要的两大类产品为信号链产品和电源管理芯片，主要包括各种放大器、模拟开关、接口电路、无线及射频 IC、数据转换芯片、各类电源管理及驱动芯片等。其中电源管理 IC，专用模拟芯片和信号转换器组件等产品将成为模拟 IC 市场成长的主要推动力。随着 5G 时代的到来，物联网、通信对射频器件的需求不断放大，推动射频器件进入快速发展时期。滤波器作为射频器件市场中最大的业务板块，新型天线和多载波聚合推动了对滤波器的更多需求。

半导体产业发展至今经历了三个阶段，第一代半导体材料以硅为代表；第二代半导体材料砷化镓也已经广泛应用；而以氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石等为代表的第三代半导体材料，凭借其高效率、高密度、高可靠性等优势，在新能源汽车、通信以及家用电器等领域发挥重要作用。此外，第五代移动通信、物联网、人工智能、工业机器人、智能穿戴行业、新能源汽车行业的快速发展也

将给集成电路带来新的增长动力。政策方面，集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府“2025 中国制造”的目标是：芯片自制率 2020 年要达到 40%，2025 年要达到 70%。依政府公布的目标，预估到 2025 年还要盖多座芯片厂。国内针对此战略发展目标，于 2015 年起各地方政府积极构思推动芯片产业的发展方案，特别是核心芯片国产化迫在眉睫。加上某些企业垄断原材料等一系列因素，电子芯片一边是减产，一边需求增长，出现了“一芯难求”的局面。受芯片短缺影响，各大芯片厂商也开展了“扩产”、“扩厂”等提升产能的“自救行动”。“十四五”规划中曾提到要加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片，发展第三代半导体产业，加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据等新兴产业。芯片产业及高阶面板产业因为国家政策大力推进建设，产业进一步细分以及新的需求增长原因，市场相对而言保持景气，故芯片厂的建设热潮必将带动高阶洁净工程市场呈现一片荣景。

此外，高质量发展是“十四五”规划纲要的主线，实现国家 2030 年碳达峰 2060 年碳中和是推动高质量发展的内在要求。加快推进碳达峰、碳中和，对内能够改善环境、倒逼产业升级、促进经济高质量发展，对外能够推动国际合作、争取外贸话语权、重塑国际竞争格局。本次报告中强调双碳工作要有序推进，着重提及煤炭的有序减量代替，有助于避免过快减量造成的供电缺口、工厂不得不错峰用电对生产的冲击；相较于去年的《政府工作报告》，本次报告进一步明确将风光电作为替代煤电的计划路径。

我公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、数据库优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势

在激烈的市场竞争中，实现了企业的稳步发展。在保持常有的客户同时，对业务领域进一步拓宽，签约金额超过 2 亿元的新客户的开发数量有二家（深圳礼鼎和武汉楚兴）、具指标意义的合肥长鑫 12 寸芯片厂洁净室工程和武汉长江存储 12 寸芯片厂二次配工程。此外，继中芯国际的上海、天津和北京厂区后，于深圳厂区也争取到订单，深圳中芯厂区签约金额也超过了 1 亿元。

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。充分掌握机遇，与几所大学推动产学研合作，深耕专业技术、培植专业人才。以导入多年的 SAP ERP 系统、OA 平台和自行开发的工程云平台，推动企业营运管理和多项目管理的信息化与即时化。并且通过系统开发将 SAP ERP 系统、OA 平台和工程云平台实现了关键数据的互联互通，例如工程云平台的物料验收和劳务计价数据能自动同步到 SAP ERP 系统，SAP ERP 系统的已开票金额、已收款金额、已付款金额等信息也能同步到工程云平台。通过这样的系统整合，既减少了相关工作的重复耗时，也提高了相关数据的准确度和及时性。

宏观方面，芯片产业因为国家政策大力推进建设，产业进一步细分以及新的需求增长原因，市场相对而言保持景气。微观方面，受芯片短缺影响，各大芯片厂商增加投资以提升产能。公司持续全力强化芯片厂的业务能力和技术能力，借此维持企业核心竞争力。公司把握回暖的市场机遇积极拓展市场，签约合同增加，主营业务收入取得较大增长。因市场环境回暖及公司加大项目结算力度，公司项目资金周转状况有所改善，所需计提的信用减值损失和合同资产减值损失同比减少，从而提升了公司整体盈利水平。

报告期内，2022 年全年实现营业收入 303,920.98 万元，营业收入目标达成率为 138.15%；2022 年净利润 15,163.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 15,053.56 万元。净利润目标达成率为 189.55%。经营活动产生的现金流量净额 26,633.04 万元。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务范围

主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。报告期内本公司主营业务没有发生变更。

### (2) 2022年度主要经营指标分析

#### A. 主营业务分行业情况

单位：元

分行业	主营营业收入	主营业务成本	毛利率
工程施工收入	2,932,207,101.34	2,632,563,786.82	10.22%
其中：洁净室系统集成	2,794,234,525.47	2,513,190,101.61	10.06%
其他	137,972,575.87	119,373,685.21	13.48%
设备销售收入	91,593,629.15	67,648,255.11	26.14%
合计	3,023,800,730.49	2,700,212,041.93	10.70%

报告期内主营业务收入 302,380.07 万元，同比上期增加了 37.20%。主要原因是公司把握回暖的市场机遇积极拓展业务，签约合同增加，相应主营业务收入取得较大增长。

2022年公司综合毛利率为10.79%与2021年度综合毛利率7.89%相比增加了2.90个百分点。

B. 主要客户销售金额情况：

序号	客户	工程收入金额（万元）	占营业收入比例（%）
1	第一名	67,581.36	22.24
2	第二名	47,539.30	15.64
3	第三名	35,752.53	11.76
4	第四名	29,002.03	9.54
5	第五名	18,925.96	6.23
	合计	198,801.18	65.41

C1. 主要设备材料供货商情况：

序号	供货商名称	金额（万元）	占设备材料采购总额比例（%）
1	宝胜科技创新股份有限公司	12,104.87	9.15
2	镇江西门子母线有限公司	9,501.76	7.18
3	惠亚科技（赣州）有限公司	7,107.52	5.37
4	上海华新丽华电力电缆有限公司	6,920.86	5.23
5	点夺机电工程江苏有限公司	6,230.23	4.71
	合计	41,865.24	31.64

C2. 主要劳务供货商情况：

序号	供货商名称	金额（万元）	占主营业务成本比例（%）
1	TAKENAKA CORPORATION	24,820.40	9.19
2	福州辰峰净化工程有限公司	11,064.43	4.10
3	苏州吉安信工程安装有限公司	8,698.70	3.22
4	科越工程（苏州）有限公司	7,072.08	2.62
5	上海鲁强机电设备安装工程有限公司	5,732.94	2.12
	合计	57,388.55	21.25

报告期内公司前五名客户销售额 198,801.18 万元，占年度销售总 65.41%；前五名材料设备供应商采购额 41,865.24 万元，占年度设备材料采购总额 31.64%；前五名劳务供应商采购额为 57,388.55 万元，占主营业务成本的比例为 21.25%。

公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

D、公司资产同比重大变动情况表：

单位：（人民币）元

资产项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		同比增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	622,776,748.98	24.20%	421,200,534.93	18.68%	47.86%
交易性金融资产	15,016,438.35	0.58%	15,026,938.36	0.67%	-0.07%
应收票据	12,234,820.25	0.48%	44,830,013.60	1.99%	-72.71%
应收账款	644,398,194.96	25.04%	573,989,884.72	25.45%	12.27%
应收款项融资	1,000,000.00	0.04%	11,900,000.00	0.53%	-91.60%
预付款项	91,695,411.10	3.56%	74,586,665.47	3.31%	22.94%
其他应收款	6,581,187.04	0.26%	7,074,644.92	0.31%	-6.98%
存货	53,350,186.49	2.07%	30,751,951.09	1.36%	73.49%
合同资产	819,613,366.97	31.85%	821,501,306.92	36.43%	-0.23%
其他流动资产	39,993,364.81	1.55%	33,589,956.34	1.49%	19.06%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,306,659,718.95</b>	<b>89.65%</b>	<b>2,034,451,896.35</b>	<b>90.21%</b>	<b>13.38%</b>
长期应收款	1,090,201.59	0.04%		0.00%	100.00%
<b>其他非流动金融资产</b>	<b>20,013,773.59</b>	<b>0.78%</b>		<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
投资性房地产	1,610,836.65	0.06%	1,919,294.73	0.09%	-16.07%
固定资产	60,729,924.10	2.36%	54,825,031.71	2.43%	10.77%
使用权资产	7,058,715.75	0.27%	340,955.44	0.02%	1970.28%
无形资产	5,621,058.95	0.22%	3,957,480.37	0.18%	42.04%

递延所得税资产	38,656,518.42	1.50%	36,991,810.84	1.64%	4.50%
其他非流动资产	131,550,988.14	5.11%	122,760,733.58	5.44%	7.16%
<b>非流动资产合计</b>	<b>266,332,017.19</b>	<b>10.35%</b>	<b>220,795,306.67</b>	<b>9.79%</b>	<b>20.62%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,572,991,736.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,255,247,203.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>14.09%</b>

变动情况说明：

(1) 货币资金期末余额较期初增加 47.86%，主要原因是工程项目本期回款情况较好，经营性现金流增加较多所致。

(2) 应收票据期末余额较期初减少 72.71%，主要原因一是本期客户采用银行承兑汇票方式回款规模比上期小，二是期初存在已贴现但未终止确认的银行承兑汇票而期末无。

(3) 应收款项融资期末余额较期初减少 91.60%，主要原因是本期回款情况较好，本公司根据现金流状况减少计划用于贴现或背书的承兑汇票规模所致。

(4) 存货期末余额较期初增加 73.49%，主要原因是本期所接项目较多，期末施工物资进场未领用安装较多所致。

(5) 长期应收款期末余额较期初增加 100.00%，主要原因是本期新增长期租赁押金所致。

(6) 其他非流动金融资产期末余额较期初增加 100.00%，主要原因是本期新增集成电路产业基金投资所致。

(7) 使用权资产期末账面价值较期初增加 1970.28%，主要原因是新加坡分公司新增经营场所长期租赁所致所致。

E、公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况表：



单位：(人民币)元

科目名称	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	4,297,609.22	3,082,425.31	1,215,183.91	39.42%
销售费用	5,528,410.50	4,299,296.55	1,229,113.95	28.59%
管理费用	74,198,555.83	63,953,809.74	10,244,746.09	16.02%
研发费用	33,492,883.53	27,298,462.24	6,194,421.29	22.69%
财务费用	-5,553,214.93	-739,967.03	-4,813,247.90	650.47%
信用减值损失	-7,285,092.80	-14,893,298.30	7,608,205.50	-51.08%
资产减值损失	-34,480,166.48	-40,039,228.73	5,559,062.25	-13.88%
营业外收入	3,709,210.86	3,400,265.90	308,944.96	9.09%
营业外支出	143,185.06	173,422.74	-30,237.68	-17.44%
所得税	28,203,283.22	1,044,839.40	27,158,443.82	2599.29%

变动情况说明：

(1) 税金及附加本期发生额较上期增加 39.42%，主要原因是本期营业收入增加，相应缴纳城建税等附加税增加所致。

(2) 财务费用本期发生额较上期变动 650.47%，主要原因一是本期投资通知存款的资金规模较大，相应获得的利息收入较多，二是本期归还部分借款，相应利息支出减少。

(3) 信用减值损失本期发生额较上期变动-51.08%，主要原因是本期应收账款增加的规模比上期小，相应计提坏账准备的金额比同期小所致。

(4) 所得税费用本期发生额较上年同期变动较大，主要原因是本期税前利润较上年同期增加，相应当期应交所得税增加所致。

F、公司现金流量表同比变动情况表：

单位：(人民币)元

科目名称	2022 年度	2021 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流入	3,211,675,538.24	1,921,885,123.88	1,289,790,414.36	67.11%
经营活动产生的现金流出	2,945,345,096.58	1,876,972,087.21	1,068,373,009.37	56.92%
经营活动产生的现金流量净额	266,330,441.66	44,913,036.67	221,417,404.99	492.99%

投资活动产生的现金流入	45,280,252.19	261,098,074.61	-215,817,822.42	-82.66%
投资活动产生的现金流出	81,966,517.89	220,762,969.52	-138,796,451.63	-62.87%
投资活动产生的现金流量净额	-36,686,265.70	40,335,105.09	-77,021,370.79	-190.95%
筹资活动产生的现金流入	52,342,475.54	58,581,853.10	-6,239,377.56	-10.65%
筹资活动产生的现金流出	49,924,287.63	167,600,800.47	-117,676,512.84	-70.21%
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,187.91	-109,018,947.37	111,437,135.28	102.22%
汇率变动对现金的影响	9,909,190.95	-3,425,866.47	13,335,057.42	389.25%
现金及现金等价物净增加额	241,971,554.82	-27,196,672.08	269,168,226.90	989.71%

变动情况说明：

(1) 经营活动现金流入量同比去年增加了 67.11%，经营活动现金流出同比去年增加了 56.92%。经营活动现金净流量与上年同期增加 22,141.74 万元，主要原因系本期营业收入增加相应收到的工程款增加及收回长账龄工程款所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量净额是比上年同期减少 7,702.14 万元，主要原因一是上期因经营资金需求，公司减少理财产品规模回笼资金较多，而本期无此种情况，二是本期购置固定资产支付的现金较上年同期增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上期末作为筹资活动现金流出的受限资金金额较大，本期该受限资金解除限制形成筹资活动现金流入所致。

## (二) 公司的未来发展展望及 2023 年度经营规划

2023 年 3 月政府工作报告中强调，“扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价

工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。”

2023 年发展主要预期目标是：国内生产总值增长 5%左右。要坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研究和应用推广。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。

2023 年的重点在重启经济，全力拼经济，把发展放在首要任务，着力扩大内需。集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国家出台《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等政策均提到，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。随着下游产品功能的日益复杂和应用领域的持续拓展，其性能要求持续提升，为集成电路行业带来新的市场需求。同时，5G 技术发展将为电源管理芯片带来广阔的市场空间。此外，以智能手环、TWS 耳机为代表的智

能可穿戴设备等新兴消费电子产品呈现快速增长，为市场带来了新热点，催生新的市场需求。目前我国高端芯片几乎完全依赖进口，严重威胁我国国防信息安全和通信、能源、工业、汽车和消费电子等支柱行业的产业安全。而全球电子产品90%的制造能力在中国，5G、物联网和人工智能行业的最大市场也是在我国。在国家对集成电路设计行业大力扶持的政策下，高端芯片技术国产替代势在必行。

集成电路产业链上游主要为半导体材料及设备，包括硅片、光刻胶、光掩膜版、靶材、CMP抛光液、电子特种气体、试剂、封装材料、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、抛光机、薄膜设备、检测设备等；中游包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测；下游为集成电路的应用，包括通讯、消费电子、计算机、汽车电子、医疗器械、新能源、工业生产、航空航天、军工安防等。未来，在5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下，我国集成电路产业的市场需求仍将不断增长。集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。目前我国存储芯片的自给率较低，尤其是DRAM及NANDFlash市场主要被美国、日韩企业所垄断，国产替代的空间较大。近年来在中美贸易摩擦频繁的背景下，掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显，存储芯片国产替代已成为必然趋势。

经历了2021-2022年上半年的较快增长，半导体芯片行业伴随着地缘政治、经济及下游主要应用疲弱，以及供应链等问题叠加的效应加速显现，行业月度增速进入快速下行通道，但底部轮廓已逐渐显现。据IC Insights预测，20世纪70年代以来，全球半导体芯片市场尚未出现过连续超过三个季度下滑的情况，全球半导体芯片产业有望在2023年一季度触底，在半导体芯片产业全球化分工合作

的框架下，中国半导体芯片产业底部信号也将得到印证，2023 年 2 季度或迎来增长。历史经验告诉我们，半导体板块股价通常领先基本面两个季度见底，因此投资者在当下不必悲观。近年来，美国对中国半导体企业的技术封锁持续加码，2020 年以来全球缺芯潮愈演愈烈。正是在这样的背景下，境内半导体芯片行业在政策推动下得以全面加速发展，半导体芯片产业已形成国内各行业最为完备的政策支持体系。

综上，复苏预期与自主可控有望成为 2023 年半导体芯片投资的主线。就复苏预期而言，2022 年受宏观环境影响终端需求疲软，使消费电子供应链进入去库存周期，目前行业基本面进入探底阶段，需求修复成为引导板块走出低谷实现反转的核心要素。在自主可控方面，随着国产化的紧迫性提升，设备零部件企业的工艺覆盖率和高端制程渗透率将加速提升，尤其在新型举国体制下，目标更明确，高难度、高精尖和“卡脖子”板块更加受益，先进制程国产化将成未来核心推动环节。中国集成电路产业市场规模持续增长，根据调研机构尚普咨询集团预测，2022 年中国集成电路产业市场规模达到了 1.28 万亿元，预计到 2025 年将达到 1.8 万亿元。中国集成电路市场的年均增长率将达到 10%。在细分市场上，中国集成电路产业的主要细分市场有：存储器、智能手机、PC、消费电子、汽车电子、工业自动化、通信设备等。其中，存储器市场是中国集成电路市场的最大细分市场，占据了市场份额的 22.5%。智能手机市场是中国集成电路市场的第二大细分市场，占据了市场份额的 21.9%。展望芯片产业整体经济发展环境，未来几年如果客户已宣布的建厂进度能够依原订计划如期推展，公司接单情况依旧能够保持稳定，营收及利润增长幅度应可期待。

2023 年，公司将市场策略继续定义为“芯”、“屏”、“人”、“云”和“能”这五

大产业，一方面是保持既有优势项目，另一方面是借机发展短板项目。其中，“芯”和“屏”对应的是国家战略支持产业，也是我司既有优势项目范围，而“人”、“云”和“能”对应的则是国家政策暖阳照耀之产业，特别是生化制药产业公司业绩预估将有明显增长。将根据市场大环境的局势把业务重点锁定 IC 上下游厂（如晶圆/光罩/封装/测试）、锂电池、云计算中心和生化制药等领域，掌握发展契机，为公司业务的发展创造新的高峰。

公司2023年发展战略为：趁势追击，既有客户做延伸，跨大海外布局与加速海外团队建置，持续技术创新。

### 1、 趁势追击，既有客户做延伸：

市场持续活络，尤其芯片市场的建厂需求依旧强势，将积极争取新建项目订单，及接续近年来累积的优质客户，利用亚翔集成核心竞争力之优势，提供给客户厂房改建与扩建需求之服务，让客户以最低的成本，提高产能、拉高良率及创造最佳利润。

### 2、 扩大海外市场布局与加速海外团队建置：

海外市场扩展方面，凭借2019年新加坡联电项目和2020年越南环旭项目的实施经验以及母公司台系客户的资源，2023年海外市场将是开花结果的一年，公司借助海外工程实施项目，积极培养具国际视野的建厂团队，为未来海外业务的拓展打好基础。

### 3、 技术创新：

2023年公司扩大研发大楼使用，针对高等级洁净室工程建厂的需要，2023年将在分子污染防治技术、节能、新产品和新工艺等领域，投入更多的研发人力与

财力，以更先进的技术及创新的产品领先市场成国内行业的领头羊。同时积极筹备实验室CNAS认证工作，实验室将结合本司业务范围和技术特点，建立完善的管理体系，对客户坚持“循规蹈矩、精益求精”的质量方针，实现向客户提供公正、公平的技术服务。在洁净室分子污染防治技术、节能、新产品和新工法等方面，持续研发新专利的申请，也为高新技术企业之永续而努力。

2023 年全年计划实现签约目标 50 亿人民币，营业额目标 35 亿人民币，净利润目标为 20,000 万元。

## 二、 公司董事会日常情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2022 年度，公司董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2021 年度总经理工作报告》
- （2）《公司 2021 年度董事会工作报告》
- （3）《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
- （4）《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
- （5）《公司 2021 年度利润分配预案》
- （6）《公司 2021 年度独立董事述职报告》
- （7）《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》

- (8) 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
- (9) 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (10) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- (11) 《关于变更公司财务负责人的议案》
- (12) 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

2、2022 年 4 月 27 日,公司召开第五届董事会第八次会议,会议由董事长姚祖骧先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《公司 2022 年第一季度报告的议案》
- (2) 《关于向商业银行申请信用额度的议案》

3、2022 年 7 月 28 日,公司召开第五届董事会第九次会议,会议由董事长姚祖骧先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《关于向商业银行申请信用额度的议案》

4、2022 年 10 月 27 日,公司召开第五届董事会第十次会议,会议由董事长姚祖骧先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《公司 2022 年第三季度报告的议案》



## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

2022年4月19日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- （1）《公司2020年度董事会工作报告》
- （2）《公司2021年度董事会工作报告》
- （3）《公司2021年度监事会工作报告》
- （4）《公司2021年年度报告全文及摘要》
- （5）《公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
- （6）《公司2021年度利润分配预案》
- （7）《公司2021年度内部控制自我评价报告》
- （8）《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- （9）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日